

12月11日，杭州钱塘新区举行了重大项目集中开工、投产活动，此次开工投产项目多达30个，总投资达663亿元。涵盖半导体、汽车、航空等多个领域。

其中包括2个半导体产业项目竣工投产，分别是士兰集昕集成电路技改项目、Ferrotec杭州中欣晶圆大尺寸半导体硅片项目。

资料显示，士兰集昕集成电路项目由士兰微子公司杭州士兰集昕微电子有限公司运行，主要生产8英寸集成电路芯片、高压集成电路和电源管理集成电路芯片、功率半导体器件芯片、MEMS传感器芯片。士兰集昕8英寸线于2017年6月底正式投产，产出逐步增加，目前已有高压集成电路、高压MOS管、低压MOS管、肖特基管、IGBT等多个产品导入量产。

今年8月，士兰微董事会审议通过了《关于投资建设士兰集昕二期项目的议案》，同意公司控股子公司杭州士兰集昕微电子有限公司（以下简称“士兰集昕”）对8吋芯片生产线进行技术改造，形成新增年产43.2万片8英寸芯片制造能力。

根据公告，士兰集昕二期项目总投资15亿元，建设周期约为五年，分两期进行。其中，一期计划投资6亿元，形成年产18万片8英寸芯片的产能。二期计划投资9亿元，形成年产25.2万片8英寸芯片的产能。

11月，士兰微董事会、监事会、股东大会再次审议通过了《关于调整募集资金投资项目相关事项的议案》，同意公司使用募集资金3亿元及自有资金0.15亿元、大基金出资3亿元共同向集华投资增资，并通过集华投资和大基金向新增募投项目之“8吋芯片生产线二期项目”的实施主体杭州士兰集昕微电子有限公司共同增资8亿元（其中3亿元为募集资金）的事项。

而杭州中欣晶圆半导体股份有限公司钱塘新区项目于2017年9月28日正式落户，注册资本29亿元，占地13.34多万平方米，厂房面积约15万平方米。项目总投资达10亿美元，建设有3条8英寸（200mm）、2条12英寸（300mm）半导体硅片生产线，量产后可实现8英寸半导体硅片年产420万枚、12英寸半导体硅片年产240万枚。

11月22日，中欣晶圆半导体大硅片项目举行竣工投产活动，杭州中欣晶圆官方微信消息，这标志着杭州中欣晶圆半导体股份有限公司大硅片项目由建设进入到试生产直至量产的全新阶段，也意味着国内首家规模最大、技术最成熟、拥有自主核心技术的真正可量产半导体大硅片生产工厂成功开启！

封面图片来源：拍信网

关于集邦咨询（TrendForce）

集邦咨询(TrendForce)是一家横跨存储、集成电路与半导体、光电显示、LED、新能源、智能终端、5G与通讯网络、汽车电子和人工智能等领域的全球高科技产业研究机构。公司在行业研究、政府产业发展规划、项目评估与可行性分析、企业咨询与战略规划、媒体营销等方面积累了丰富的丰富经验，是政企客户在高科技领域进行产业分析、规划评估、顾问咨询、品牌宣传的最佳合作伙伴。

研究报告咨询：0755-82838930-2101

商务合作请加微信：18128855903 (Linna)

加入集邦半导体交流群，请加微信：DRAMeXchange2019